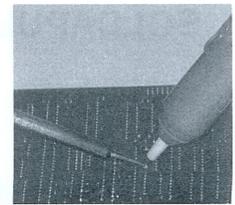




DS 017 DELUXE SOLDAPULLT Entlötgerät

das Hochleistungsentlötgerät aus der SOLDAPULLT Familie kann auch große Entlötstellen einfach Absaugen durch den hohen Vakuumimpuls

Heavy duty desoldering tool of the SOLDAPULLT Family for easy desoldering of large solder joints with high vacuum impulse



nicht haftende Entlötdüse, automatische Reinigung nach jedem Entlötvorgang

schnelle Vakuumwirkung

auswechselbare Entlötdüse

Lotauffangbehälter

Saugkolbenmechanismus

innenliegender Reinigungsstab

bequem geformter Handgriff

Laufhülse aus dauerhaftem, schlagfestem Kunststoff

Schnellverschluss zum Reinigen und Schmieren des Geräteinneren

Auslöseknopf

Schutzschienen

Saugkolben

besonders kräftige Innenfeder

stabile Konstruktion für lange Lebensdauer

stabiler Spannkopf



Spannen

Das Hochleistungs-Entlötgerät DELUXE SOLDAPULLT DS 017 mit Einhandbedienung eignet sich zur Nachbearbeitung und zum Entfernen aller elektronischer Bauteile.

Achtung:

Empfindliche MOS-LSI Halbleiterbauteile können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Für Arbeiten an solchen Bauteilen wird die Verwendung von antistatischen SOLDAPULLT Entlötgeräten, z.B. **DS 017 LS**, empfohlen.

Entlöten

Das Gerät wird nach den Anweisungen der Zeichnung gespannt, die Lötstelle mit dem Lötkolben erhitzt, bis das Lot schmilzt und sich verflüssigt. Dann wird die Spitze **SRT 12** des Entlötgerätes leicht dageengehalten und der Auslöseknopf betätigt, um das Lot von der Verbindungsstelle abzusaugen. Den Vorgang zur vollständigen Reinigung der Lötstelle nach Bedarf wiederholen.

Um die Lebensdauer der Spitze zu erhöhen, ist das Gerät ohne jeglichen Druck an die Lötstelle zu halten.

Achtung:

Beim Spannen ist das Gerät stets so zu halten, daß die Spitze des Entlötgerätes vom Gesicht abgewendet ist, das Gerät ist auch nie auf eine andere Person zu richten. Vermeiden Sie, daß ausgestoßenes Lot auf die Leiterplatte fällt und möglicherweise einen Kurzschluß verursacht.

Ersatz-Entlötdüse: SRT 12

Ersatz-O-Ring: ODS 31

Regelmäßige Reinigung / Wartung

- 1.) Spanngriff, wie beim Laden eindrücken
- 2.) Weiterdrücken bis der Reinigungsstab aus der Spitze ragt
- 3.) noch fester nach vorne drücken, bis die Entlötdüse aus der Fassung gestoßen wird
- 4.) Entlötdüse abnehmen
- 5.) gründlich reinigen und mit OL 111 schmieren
- 6.) Entlötdüse wieder fest in die Hülse drücken

Achtung: Beim Wiedereinsetzen nicht auf die Spitze drücken, sondern auf den Kunststoffsockel der Spitze.

Heavy duty desoldering tool of the SOLDAPULLT Family for easy desoldering of large solder joints with high vacuum impulse

Attention:

Sensitive MOS-LSI semiconductor components can be damaged by static electricity. For soldering work on such components we recommend to use antistatic SOLDAPULLT desoldering tools, e. g. **DS 017 LS**.

Desoldering:

The tool has to be loaded according to the instructions given in the drawing. The solder joint is heated by means of the soldering tool till solder melts and liquefies. Direct the tip SRT 12 of the desoldering tool cautiously just above the solder joint, press the release button in order to extract the solder by suction. If necessary repeat this procedure till the solder joint is completely cleaned.

To assure a long durability of the tip the tool should be applied without imposing any pressure upon the solder joint.

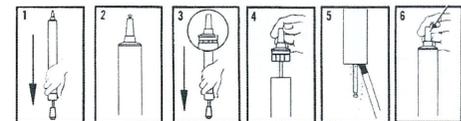
Attention:

When loading, the tip of the desoldering tool must always be turned away from the face.

Never direct the tool at other persons. Avoid solder dropping on the circuit board, this can possibly short-circuit.

Replacement Tip: SRT 12

Replacement-O-Ring: ODS 31



Regular cleaning/ maintenance

- 1.) Press grip as when loading.
 - 2.) Continue pressing till cleaning shaft protrudes from the tip.
 - 3.) Press forward more securely till the desoldering tip comes out of its holder device.
 - 4.) Remove desoldering tip.
 - 5.) Clean thoroughly and lube with OL 111.
 - 6.) Reattach the desoldering tip into its sleeve.
- Attention:** Do not press on the tip when reattaching, only on the plastic socket of the tip

DS 017 DELUXE SOLDAPULLT Entlötgerät

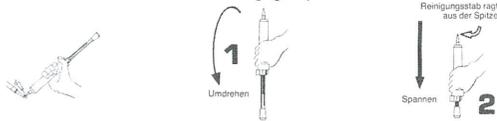
das allseits bekannte Hochleistungsentlötgerät aus der SOLDAPULLT - Familie - einfache Handhabung bei großer Wirkung

The well known heavy duty desoldering tool of the SOLDAPULLT Family – easy application and high efficiency



Spannen des SOLDAPULLT Entlötgerätes

Man hält das SOLDAPULLT fest in der Hand, die Spitze auf die Werkbank oder eine ähnliche harte Oberfläche gerichtet. Ohne die Handposition zu verändern, wird das Gerät umgedreht und der Spannkopf fest gegen die Werkbank gedrückt, bis der Reinigungsstab aus der Spitze herausragt. Schon ist das SOLDAPULLT betriebsfertig gespannt.

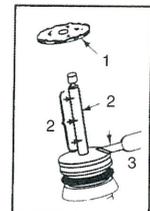


Loading of the desoldering tool

Hold the SOLDAPULLT tight in your hand, direct the tip to a work bench or a similar structured surface. Without changing hand position the tool is to be turned round and the chuck head has to be pressed firmly against the work bench till cleaning shaft protrudes from the tip. The SOLDAPULLT is now loaded and ready for operation.



- 1 Flußmittelrückstände / flux residues
- 2 Fetten mit OL 111 / lubricate with OL 111
- 3 Messer zum Reinigen / knife for cleaning



Entfernen von Flußmittel- und Lotrückständen

In Fällen, bei denen flüssiges Flußmittel beim Löten oder Entlöten verwendet wird, ist eine häufige Reinigung des Stabs und der Stirnfläche des Saugkolbens notwendig, um ein Festsetzen des Reinigungsstabes in der Entlötdüse zu verhindern. Auch kann sich gelegentlich eine Kappe aus verflüssigtem Lot- und Flußmittel auf der Saugkolbenfläche / Abprellplatte bilden.

Um die Flußmittelrückstände zu entfernen, wird das Gehäuse und der Saugkolben nach den Schritten 1 bis einschließlich 3 des "Gründlichen Reinigungsverfahrens" auseinandergenommen; der Stab und die Stirnfläche des Saugkolbens ist rundum sorgfältig abzukratzen, dann ist der Stab über die ganze Länge mit dem **O-Ring-Schmiermittel OL111** einzufetten. Falls sich eine Kappe aus Lotrückständen gebildet hat, ist diese vorsichtig mit einer Messerklinge abzuheben; der Stab ist rundum abzukratzen, um Flußmittelrückstände zu beseitigen, und dann in seiner ganzen Länge mit Schmieröl OL111 einzufetten.

Cleaning of solder forming flux and solder residues

In case of using liquid solder flux for soldering and desoldering works the shaft and the abutting face of the suction device must be cleaned frequently in order to avoid that the cleaning shaft gets suck in the desoldering tip. Clogging due to molten solder or solder forming flux can sometimes be possible.

In order to take off the solder flux residues the housing and the suction device are disassembled according the steps 1 incl. step 3 described under "Basic cleaning procedure". The shaft and the abutting surface of the suction device must be cleaned accurately. The whole shaft length has to be lubed with **o-ring lube OL 111**. Incidental clogging due to solder residues will be scraped off carefully by means of a razor blade. The shaft has to be cleaned all around in order to take off any solder flux residues, afterwards the shaft must be lubricated with lube OL 111 over its whole length.

Entlöt tips

Wenn noch Lot zurückbleibt, füllt man die Verbindungsstelle mit Lot auf und wiederholt den Entlötvorgang. Zum Lösen von Anschlußdrähten, die an der Leiterplatte haften bleiben, verwendet man eine Pinzette oder Zange oder die Entlöthilfe **WIGAPRY WP286**.

Desoldering advice

In case of residual solder the joint parts are refilled with solder and the desoldering procedure is repeated. For desoldering of connecting wires adhering on circuit boards we recommend use of a pick up tool, pliers or desoldering aid **WIGAPRY WP 286**.

